

<<表面组装技术>>

图书基本信息

书名：<<表面组装技术>>

13位ISBN编号：9787111216551

10位ISBN编号：7111216555

出版时间：2007-9

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<表面组装技术>>

内容概要

表面组装技术(SMT)是电子元器件的一种新型组装技术。

本书依据表面组装技术的最新标准,突出无铅化的发展趋势和应用特点,比较全面系统地介绍了国内外表面组装技术的发展与最新技术动态,主要内容包括电子元器件组装技术的演变、表面组装技术应用现状与发展趋势、表面组装元器件、表面组装印制电路板、焊膏涂敷技术、元器件贴装技术、表面组装焊接材料、波峰焊与再流焊技术、表面组装清洗技术、表面组装测试技术、静电防护与返修技术等。

本书内容新颖丰富、翔实全面、覆盖面广,行文通俗易懂,兼备知识性、系统性、可读性、实用性和指导性,技术理论与应用实践相结合的主导思想始终贯穿于全书。

本书可作为从事电子产品和电子系统设计、制造的广大工程技术人员、实验人员和维修人员的技术参考书,也可作为高等院校SMT专业或专业方向的本科教材和高等职业技术教育教材。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>